

广东利扬芯片测试股份有限公司

关于自愿披露全资子公司签订日常经营重大合同的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示：

- **合同类型：**销售合同（以下简称“合同”或“本合同”）
- **合同金额：**预估合同金额合计为人民币 6,500.00 万元。
- **合同期限：**自双方签署生效之日起 1 年，期满自然终止，如任一方有意续签，可提前 15 天向另一方提出，双方协商一致后予以书面确认。
- **对上市公司业绩的影响：**本次签署的合同与利阳芯日常经营活动相关，利阳芯将根据合同的相关条款约定，在合同履行期间各月度确认销售收入。本合同的签订为合同相对方提供晶圆减薄，切割及相关配套服务（含晶圆减薄、抛光，激光开槽，激光隐切等系列技术工艺服务），将进一步提升公司的市场地位，有利于提高公司的持续盈利能力和核心竞争力，对公司业务发展及经营业绩将产生积极的影响。合同相对方与本公司不存在关联关系，本次合同签订对公司业务独立性不构成影响，不会因履行合同对上述合同相对方形成依赖。
- **风险提示：**合同双方均具有良好的履约能力，但在合同履行过程中，若受外部宏观环境、市场环境等不可预测或不可抗力因素影响，可能存在导致合同无法如期或全部履行的风险。合同执行过程中，可能存在产能紧张原因使得未能按时提供技术服务，导致公司承担违约责任的风险。公司将积极做好相关应对措施，全力保障合同正常履行，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、审议程序情况

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司利阳芯（东

莞)微电子有限公司(以下简称“利阳芯”)近期分别与客户 A、客户 B(以下统称“合同相对方”)签署提供晶圆减薄,切割及相关配套服务(含晶圆减薄、抛光,激光开槽,激光隐切等系列技术工艺服务),预估金额合计为人民币 6,500.00 万元。本合同为利阳芯日常经营性合同,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,公司已履行了签署本合同相应的内部合同审批流程,该事项无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

根据合同相对方的保密要求,本次具体交易信息属于商业秘密、商业敏感信息。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,按照本规则披露或者履行相关义务可能引致不正当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的,可以按照相关规定暂缓或者豁免披露该信息。公司根据《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》,填制《信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表》《信息披露暂缓或豁免业务事项知情人登记表》,履行了信息豁免披露程序,因此公司对本次交易的信息进行了豁免披露。

二、合同标的和相对方当事人情况

(一) 合同标的情况及合计金额

合同标的为提供晶圆减薄,切割及相关配套服务(含晶圆减薄、抛光,激光开槽,激光隐切等系列技术工艺服务),预估合同金额合计为人民币 6,500.00 万元,具体以双方签订确认的报价单及实际交易价格为准。

(二) 合同相对方当事人情况

- 1、单位名称:客户 A、客户 B
- 2、公司已履行内部信息披露豁免程序,对合同相对方的相关信息进行了豁免披露。
- 3、客户 A、客户 B 具有良好的信用,具备良好的履约能力。

(三) **合同期限:**自双方签署生效之日起 1 年,期满自然终止,如任一方有意续签,可提前 15 天向另一方提出,双方协商一致后予以书面确认。

(四) **合同其他条款:**合同对委托加工内容、费用及付款方式、产品质量及责任、知识产权、双方权利与义务、保密责任、存续与终止、违约责任、争议解决等进行了明确的约定。

(五) 关联关系说明

公司与客户 A、客户 B 之间不存在关联关系。

四、合同履行对公司的影响

本次签署的合同与利阳芯日常经营活动相关，利阳芯将根据合同的相关条款约定，在合同履行期间各月度确认销售收入。本合同的签订为合同相对方提供晶圆减薄，切割及相关配套服务（含晶圆减薄、抛光，激光开槽，激光隐切等系列技术工艺服务），将进一步提升公司的市场地位，有利于提高公司的持续盈利能力和核心竞争力，对公司业务发展及经营业绩将产生积极的影响。

合同相对方与本公司不存在关联关系，本次合同签订对公司业务独立性不构成影响，不会因履行合同对上述合同相对方形成依赖。

五、相关风险提示

合同双方均具有良好的履约能力，但在合同履行过程中，若受外部宏观环境、市场环境等不可预测或不可抗力因素影响，可能存在导致合同无法如期或全部履行的风险。合同执行过程中，可能存在产能紧张原因使得未能按时提供技术服务，导致公司承担违约责任的风险。

公司将积极做好相关应对措施，全力保障合同正常履行，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2024 年 2 月 2 日